

CONES DE SYNCHRONISEUR QUALITE DE METALLISATION AU MOLYBDENE

Page 1/4

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

SOMMAIRE

1. OBJET	1
2. EXPRESSION SUR DOCUMENTS	1
3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	1
ANNEXE	3
4. HISTORIQUE ET DOCUMENT CITÉS	4
4.1. HISTORIQUE	4
4.2. DOCUMENTS CITÉS	4
4.3. EQUIVALENT À :	4
4.4. CONFORME À :	4
4.5. MOTS CLEFS	4

1.OBJET

La présente spécification a pour objet la définition des caractéristiques techniques et des examens à effectuer pour contrôler la qualité de la métallisation au molybdène des cônes simples ou doubles de synchroniseur.

2.EXPRESSION SUR DOCUMENTS

L'application des exigences de la présente spécification doit être indiquée sur les documents par la désignation du produit, suivie de l'indice du document.

Exemple :

REVETEMENT MOLYBDENE STL S23 2123.

3.CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Document s	CARACTERISTIQUES	Expressio n des Résultats	EXIGENCES	
			Min.	Max.
	3.1 TAUX DE SURFACE PORTANTE (TSP)			
	Le Taux de Surface Portante, exprimé en %, doit être conforme aux exigences portées sur les plans des cônes synchroniseurs.	%	30	65
	3.2 TAILLE MOYENNE DES PLATEAUX CONSTITUANT LA SURFACE			

CONES DE SYNCHRONISEUR - METALLISATION	S23 2123	2/4
---	-----------------	-----

	Avec la mesure du TSP, le logiciel d'analyse d'image fournit la taille des plateaux constituant la surface. Cette taille moyenne des plateaux, exprimée en μm^2 , doit être conforme aux exigences portées sur les plans des cônes synchroniseurs.	μm^2	3600	6400
B50 0310	3.3 DURETE			
	La dureté, exprimée en Vickers, est relevée sur une coupe micrographique non attaquée (voir en annexe la préparation de l'échantillon), sous une charge de 100 g. Le résultat exprimé est une moyenne de 10 mesures. Les points de mesure retenus sont ceux dont les deux diagonales de l'empreinte, de longueur telle que l'écart entre elles sont inférieur à 0,5 μm .	HV 0,1	700	1100
	3.4 POROSITE			
	Le taux de porosité, exprimé en %, est mesuré sur une coupe micrographique non attaquée.	%		8
	3.5 LIAISON AVEC LE SUBSTRAT			
	Elle est estimée en % de la surface du dépôt qui épouse parfaitement le substrat. Cette mesure est réalisée sur une coupe micrographique non attaquée.	%	70	